



当社製品例

- 本社所在地：東京都練馬区
- 事業概要：金属加工・精密部品加工・切削加工。半導体製造装置向け精密部品を主軸に、自動車・医療関連部品等も幅広く供給
- 常時使用する従業員：59名
(2026年8月時点)
- 現在の売上高：16.6億円
(2026年5月期)
- 法人番号：4011601001621
- Web：https://kkyowaseiki.co.jp/

企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役
立松 徳昭

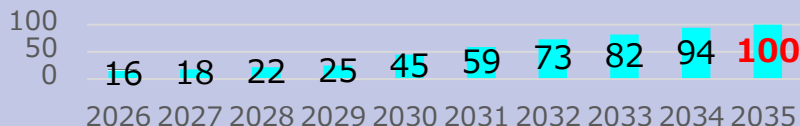
つながる力で、ものづくりの高みへ

私たち協和精機は、半世紀にわたり半導体製造装置等の精密部品を手がけ、日本のものづくりの最前線を支えてきました。これからは、熟練の技を若手へ継ぎながら自動化で磨き上げた製造力を核に、「協和精機ものづくりプラットフォーム」を築き上げます。培った技術に磨きをかけ、半導体から宇宙・防衛へと挑戦の舞台を広げ、地域から日本のものづくりを牽引する企業を目指します。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

2035年に売上高100億円を目標とする。現在の16.6億円から約6倍の成長を、自社受注拡大・M&A・技術パッケージの3つの柱で、自社単体として実現する。



課題

- ・注文の引き合いや商談はあるが、当社が受注できる案件数・生産キャパシティが不足している
- ・新工場の稼働と自動化により、受注対応力を計画的に拡大する必要がある
- ・売上が半導体に集中し、航空宇宙・防衛への展開が必須
- ・熟練技術者の技術力の継承と、自動化との両立も課題

売上高100億円実現に向けた具体的措置

目指す成長手段

- ・新工場の稼働で自社の製造力を強化（試作・量産のダブルフロア、量産の自動化）
- ・生産キャパシティの拡充を進め、旺盛な引き合いを受注に結びつける
- ・M&Aにより技術・顧客層を獲得し、技術力・受注力の向上に活用する（買収先の売上高は本目標に含まない）
- ・製造ノウハウを外販する技術パッケージ事業を立上げる
- ・培った精密加工技術で航空宇宙・防衛分野へ参入

実施体制

- ・推進体制：代表取締役を統括責任者とする全社横断での推進体制を構築
- ・技術・自動化：専任チームを新設し、熟練技術の継承と自動化の両立を主導
- ・生産管理：受注窓口を一元化し、工程・品質管理体制を強化
- ・M&A・新規事業：M&Aで獲得した技術・人材を活かすための体制を段階的に整備